

# フィルム基板密着固定用 マジックレジジンキャリア

FPC・COF・TCP等のフィルム状基板を接着剤やテープを使用することなく  
密着・固定し搬送・固定治具として使用できる新タイプのキャリアボード

## <用途・特徴>

耐熱テープ等を使わずに、印刷 搭載 リフロー加熱の一連の工程を同一キャリアで固定・搬送

裏面に部品が実装してある場合でも、ザグリ・穴開け等の立体加工を施す事により対応可能

耐熱・耐久性に優れる<リフロー500サイクル以上>

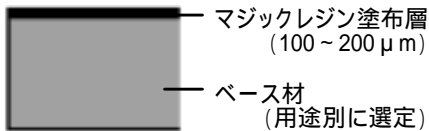
メンテナンス性に優れる(IPA、水、中性洗剤等で手軽に洗浄可能)

位置合わせ治具を併用することにより、印刷および部品搭載時に要求される厳密な位置精度を実現

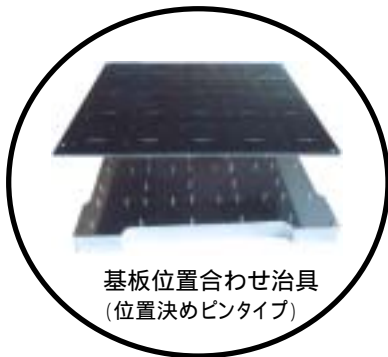


(写真:上・左)  
COFをキャリア  
にセットした様子

## 断面図(ボードの層構造)



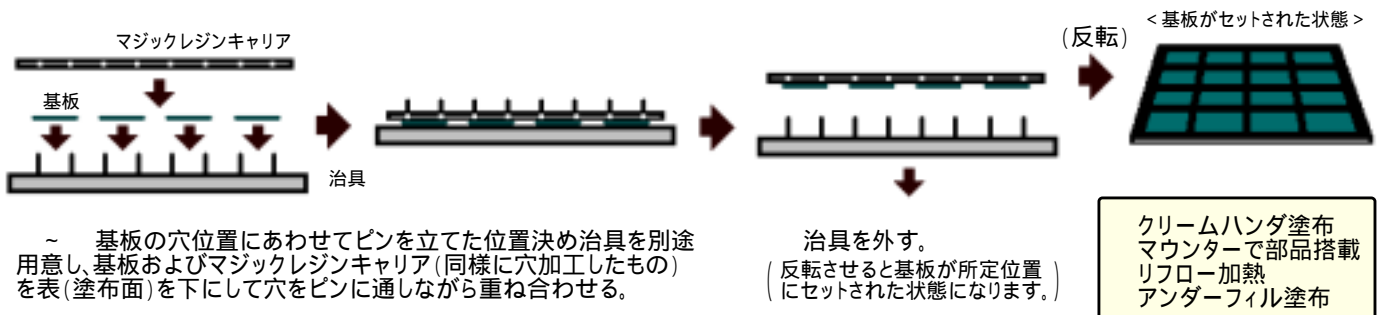
ベース材の表面に樹脂(マジックレジジン)を薄く均一にコーティングした状態の2層構造



基板位置合わせ治具  
(位置決めピンタイプ)

分類	外形サイズ	塗布範囲	粘着力	レジジン塗布厚	レジジン種別	ベース材				
						厚み	材質(*)			
							ASC	BG	AL	SUS
K	最大250×330mmの範囲内で任意に設定可能。	全面	強	0.2mm	シリコン系	1.6 または 2.0mm		-		-
T			最強					-		-
C		部分(任意)	中	0.1 または 0.2mm		任意		-		
D	弱				-					
ZERO		弱			ノンシリコン系			-		

## 基板位置合わせ治具(位置決めピンタイプ)を併用したCOF装着例



## マジックレジジンボード(未加工の原板販売品)

加工を施していないマジックレジジンキャリアの原板を単体で販売しているもので、外形サイズ:495×295mm(レジジン塗布範囲:460×260mm)の未加工ボードです。

